

日期：106年8月2日
便簽 單位：研究發展處
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：

計畫業務組 擬辦：

- 一、文陳閱後，公告於電子公佈欄、本組、本處及本校最新消息，並e-mail副知全校教師知照。
- 二、本計畫校內申請截止日為106年9月26日上午10時，欲申請者請於校內截止日前於科技部系統完成線上申請作業，並來電與本組確認，俾利本組於期限前彙送科技部，逾期恕不受理。
- 三、另提醒申請者於提出計畫申請案前，務必更新或確認個人資料（職稱請以人事室核發之正式職稱為準）。
- 四、文存。

會辦單位：

第二層決行		
承辦單位	會辦單位	決行
行政組 張譯云 0802 0905		
副教授 李思禹 0802 兼組長 0913		
教授 兼 洪慧芝 0802 研究發展組長 0913		代為決行
		教授 兼 洪慧芝 0802 研究發展組長 0913



科技部 函

機關地址：台北市和平東路二段106號
聯絡人：陳怡婷
電話：02-2737-7280
傳真：02-2737-7619
電子信箱：yitchen@most.gov.tw

受文者：國立中興大學

發文日期：中華民國106年8月1日

發文字號：科部產字第1060054048號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：產學研發聯盟產學合作計畫徵求說明書 1份 (106D2019053.DOC)
(GSSATTCH1 A09550000Q0000000_106D2019053.DOC)

主旨：本部107年「產學研發聯盟合作計畫-半導體領域試辦計畫」自即日起受理線上申請，申請機構須於106年9月29日(星期五)前將申請名冊函送本部，逾期不予受理，請查照轉知。

說明：

- 一、旨揭計畫執行期限自107年1月1日起至12月31日止，檢附徵求說明書1份如附件，計畫書採用本部專題研究計畫申請書格式，申請機構須併同檢附聯盟出具之聯盟推薦證明文件(附件1)、申請人與企業之合作約定書(附件2)向本部提出申請，並說明本計畫與吸引業界提供經費投入研發內容之關聯，相關申請事宜如下：

(一)申請資格：

- 1、申請機構(即執行機構)：符合本部補助專題研究計畫作業要點第二點規定者。
- 2、計畫主持人(申請人)及共同主持人：符合本部補助專題研究計畫作業要點第三點規定者。
- 3、產學研發聯盟(下稱聯盟)：其設立宗旨為促進產學合



作、推動產業前瞻技術研發。聯盟為計畫申請之推薦機構，確認計畫內容屬於聯盟及業界認可之產業前瞻技術研究。

4、合作企業：指符合本部補助產學合作研究計畫作業要點第二點規定者。申請本計畫之申請人，須吸引業界提供經費投入研發，並與本計畫之執行重疊一定期間。

(二)審查作業包括初審書面審查及複審會議審查，審查重點摘要如下：

1、計畫之研究主題必須具有前瞻性或創新性，以解決未來重要問題為目的；在前瞻性方面應屬於「產業等級」而非「公司等級」，將排除廠商進行國內競爭者現有技術之申請案。

2、博士生或博士後參與研究計畫，或業界有吸納計畫內博士生或博士後誘因相關承諾者，將優先考量。

二、系統操作服務專線：本部資訊處(02)2737-7590~92。

正本：專題研究計畫受補助單位（共302單位）、台灣半導體產業協會

副本：本部綜合規劃司、產學園區司、財團法人國家實驗研究院（產學研發聯盟合作計畫辦公室）

106/08/01
16:19:47

部長陳良基

產學研發聯盟合作計畫-半導體領域試辦計畫
徵求說明書



目 錄

壹、背景說明	- 2 -
貳、徵求計畫	- 2 -
參、審查重點	- 3 -
肆、申請辦法及相關資訊.....	- 3 -

產學研發聯盟合作計畫

計畫徵求說明

壹、背景說明



我國半導體產業經過三十餘年的發展，已經形成高效率的分工體系，造就舉世知名的半導體兆元產業。在 2015 年，我國晶片（IC）設計業排名世界第二，僅次於美國；晶圓代工與晶片封測業居全球第一；記憶體製造領域排名世界第四，僅次於韓國、美國與日本。以產值計算，半導體為我國最重要之製造業，有多家代表性企業成為全球市場的重要成員，在國內同樣舉足輕重，堪稱是我國經濟發展的火車頭。

在半導體領域的研究方面，同樣在學術界的努力與政府的長期支持下，也具有國際級的研究能量。現今，面對未來科技發展與市場快速成長的契機，還有來自全球競爭對手的嚴峻挑戰，如何透過政府資源的有效運用，進一步鏈結產業界及學術界，共同提升我國半導體產業各領域的競爭力，已成為關鍵課題。

著眼於國家科技、經濟與產業發展的迫切需求，科技部（以下簡稱本部）鼓勵國內產業界與學術界組成產學研發聯盟，透過創新的產學合作模式，引導產業界、學術界結合研發能量，並共同規劃未來關鍵研究主題，促進產學共同投入產業前瞻技術研究，以強化產業發展的關鍵技術研發及智財布局，更協助產業界、學術界共同培育高階研發領導人才。為此，106 年本部公開徵求各大學院校及研究機構，與國內半導體領域產學研發聯盟合作，申請「產學研發聯盟合作計畫」，以確保、提升我國半導體產業的國際領先地位與競爭實力。



貳、徵求計畫

一、申請資格

- (一) 申請機構(即執行機構)：符合本部補助專題研究計畫作業要點第二點規定者。
- (二) 計畫主持人(申請人)及共同主持人：符合本部補助專題研究計畫作業要點第三點規定者。
- (三) 產學研發聯盟(下稱聯盟)：其設立宗旨為促進產學合作、推動產業前瞻技術研發。聯盟為計畫申請之推薦機構，確認計畫內容屬於聯盟及業界認可之產業前瞻技術研究。
- (四) 合作企業：指符合本部「補助產學合作研究計畫作業要點」第二點規定者。申請本計畫之申請人，須吸引業界提供經費投入研發，並與本計畫之執行重疊一定期間。

二、申請階段及注意事項

- (一) 針對我國面臨國際競爭具高度迫切性、具前瞻技術及高階人才需求之關鍵產業，本部

鼓勵籌組產學研發聯盟，106 年先以半導體領域先行試辦，並分類為 IC 設計、製造及封測三組。

- (二) 計畫申請書審查：由執行機構檢附聯盟出具之聯盟推薦證明文件（附件一）、申請人與企業之合作約定書（附件二）及計畫申請書向本部提出申請，並說明本計畫與吸引業界提供經費投入研發內容之關聯。本部得通知計畫申請人到部報告。
- (三) 執行機構應於公告受理期間內向本部提出申請，逾期不予受理。
- (四) 計畫書審查期間自申請文件完整交付之次日起三個月內完成；必要時，得予以延長。審查期間不含補正及陳述意見之期間。
- (五) 本部依審查結果核給補助額度。
- (六) 計畫執行期間自 107 年 1 月 1 起開始執行；申請機構得申請多年期計畫（至多三年），本部將依審查結果決定是否核給分年核定多年期計畫。二年期以上計畫，應於當年計畫結束三個月前線上繳交當年計畫執行之精簡進度報告及完整進度報告以供審核，作為下年度之撥款依據。

參、審查重點



本部得依計畫之領域性質及特色，聘請企業界、學術研究機構、科技行政單位之學者專家，組成審查小組，負責計畫審查，審查作業包括初審書面審查及複審會議審查，如有必要將安排請人簡報計畫構想及內容。審查重點如次：

- 一、計畫團隊研究群之執行能力、研究主題與目標，企業界之技術需求、所提產業前瞻技術研究之關鍵性、過去執行產學合作計畫之績效、預期研發成果及產業外溢效果等。
- 二、研究項目及經費需求。
- 三、合作企業之資格、研發能力或潛力、出資、承接計畫成果之意願與承諾（包括技術移轉之協議等）及計畫成果之後續研發能力。
- 四、計畫各年及全程之預期績效。
- 五、吸引業界投入經費說明、權利義務規範等文件。
- 六、申請計畫是否包含下列優先補助參考情事：
 - (一) 博士研究生或博士後研究人員參與研究計畫者，得作為優先補助之審查參考。
 - (二) 業界有吸納計畫內博士班研究生或博士後研究人員誘因相關承諾者，於申請時須一併提供相關證明文件。
- 七、其他審查有關事項。

肆、申請辦法及相關資訊

一、計畫申請書格式及申請辦法

- (一) 計畫書請採用科技部專題研究計畫申請書格式，計畫書總頁數須 100 頁以內為原則，



並註明申請組別(IC設計、製造或封測)。

- (二) 自即日起至106年9月29日止，備齊相關資料，逕行上傳本部專題研究計畫補助資訊系統申請，並備函送達本部，文件不全或不符合規定者，不予受理。
- (三) 計畫審查會議，由申請團隊向審查委員會作計畫簡報說明，詳細時間、地點將另行通知。

二、執行規範：

(一) 本部得補助下列項目所需費用：

1. 業務費：

(1) 研究人力費：

A. 專、兼任助理費用及臨時工資。

B. 博士後研究人員費用；

(2) 耗材、物品、圖書及雜項費用：與本聯盟產學合作計畫直接有關之其他費用等。

2. 研究設備費。

3. 管理費。

(二) 吸引業界投入經費得支應下列費用：

1. 研究主持費：由執行機構、主持人及合作企業共同商議。

2. 業務費：

(1) 研究人力費：專、兼任助理、博士後研究人員等研究人力費用。

(2) 耗材、物品、圖書及雜項費用。

3. 研究設備費。

4. 國外差旅費：出席國際會議差旅費、國外或大陸地區差旅費。

5. 管理費。

(三) 博士後研究人員得因執行計畫需要至合作企業參與研發，其工作內容、期間等相關事項由計畫執行機構以契約明定。

(四) 吸引業界投入經費應高於申請本部補助經費，業界提供經費之計算，得回溯至本計畫當年度徵求公告日當月起至本計畫執行迄日止，且應與本部計畫執行期間重疊一定期間。

(五) 業界提供經費應使用於計畫之執行或與計畫執行相關之事項，不得任意支用。

(六) 博士班研究生參與本計畫之研究人力費用，本部至少補助1.5萬元，業界提供經費應有相對額度之投入。另業界承諾額外資助博士研究生每位每月新臺幣1萬元以上之獎學金者，除原依規定支領研究計畫兼任助理費用外，得依「科技部鼓勵企業參與培育博士研究生試辦方案」，於本計畫補助期間內，每月支領本部專款補助與企業同額之獎學金，惟本部額外專款補助部分以每月2萬元為上限，且累計補助金額不受本部補助研究計畫兼任助理費用支給標準表之限制。計畫執行機構得於當年度本部補助經費第二期款項撥款前開立並出具業界資助博士研究生獎學金之證明文件。

(七) 計畫內核給博士後研究人員及博士班研究生經費，如因研究計畫需要，得報經本部同意變更後，於研究人力費內調整運用。

(八) 執行機構應制定研發成果之規範或整體機制，以加強研發成果之管理、推廣及運用，

具體落實推動產學合作之目標。

- (九) 合作企業提供研究經費、撥付管理與使用、申請補助項目、其他與計畫相關之權利義務等，應事先以書面約定。
- (十) 若執行機構未能於當年度本部補助經費第二期款項撥款前開立並出具業界出資證明文件，或計畫之年度目標未能達成，本部將採分期管考方式，當期未達成約定事項者，終止下期以後之補助經費，並納入本部後續補助之參考。

三、研發成果：

本部出資部分歸屬計畫執行機構，其餘成果歸屬由計畫執行機構與合作企業依本部補助產學合作計畫作業要點及相關規定商議約定。

計畫主持人於本計畫執行期間變更所屬單位時，其研發成果之歸屬、管理及運用等相關問題，由變更前、後所屬單位與計畫主持人議定之，並由計畫執行機構函報本部同意後辦理。

計畫執行機構及計畫主持人合作企業運用或推廣研發成果時，在未獲得本部書面同意前，不得在利用研發成果時（包括但不限於產品、商品或服務之公開行銷、推廣或廣告文宣等），引用本部之名稱、部徽或其他表徵；亦不得以其他任何方式表示本部與計畫執行機構及合作企業有任何關連。聯盟會員若違反前開規定，計畫執行機構或計畫主持人應立即通知本部為必要之處理。

計畫執行機構、計畫主持人在研發成果獲准專利後，應明確標示專利證書號數。

四、產學研發聯盟應規劃並負責下列事項：

- (一) 聯盟之任務應包括媒合及促進產學合作計畫。
- (二) 為確保產學合作計畫之推動，聯盟應制定專屬之產學合作計畫作業、計畫經費管理，以及研發成果之管理與運用等相關規範或整體機制，以具體達成產學合作計畫推動目標，加強研發成果之管理、推廣及應用。
- (三) 聯盟應提出未來關鍵研究主題規劃，規劃範疇及產學合作計畫內容須以產業前瞻技術研究為主。
- (四) 聯盟應確認推薦計畫之內容屬於聯盟及業界認可之產業前瞻技術研究、與吸引業界提供經費投入研發內容之關聯性等。

五、結案報告

- (一) 計畫結束後三個月內，申請機構應向本部繳交計畫研究成果精簡報告及完整結案報告（電子檔），並將產生之研發成果及對產業技術提升之績效等相關資料，辦理登錄作業，並具體展示。
- (二) 二年期以上計畫，應於當年計畫結束三個月前線上繳交當年計畫執行之精簡進度報告及完整進度報告以供審核，作為下年度之撥款依據。
- (三) 計畫主持人對前二項計畫之精簡報告、完整報告及研發成果實際運用績效登錄等內容，應負完全責任。如因涉及專利、技術移轉案或其他智慧財產權等，而不宜對外公開者，請勿將其列入精簡報告，原則上本部將公開精簡報告。

六、其他未盡事宜請依「科技部補助產業前瞻技術計畫作業要點」及其他相關規定辦理。

七、聯絡方式

科技部產學研發聯盟合作計畫辦公室

聯絡人：張文馨

電話：02-2737-7008

科技部產學及園區業務司

承辦人：陳怡婷

電話：02-2737-7280



【○○○○聯盟推薦計畫證明文件】(參考格式)

申請人_____吸引業界_____投入屬產業前瞻技術
研究與開發(合作主題:_____)之研發經費,滿足下列條件:

1. 投入經費預計執行期間:自____年____月____日至____年____月____日止
投入經費已執行期間:自____年____月____日至____年____月____日止
2. 企業承諾出資研發經費
(第一年:_____仟元;第二年:_____仟元;第三年:_____仟元)
企業已撥付研發經費
(第一年:_____仟元;第二年:_____仟元;第三年:_____仟元)
3. 檢附【申請人與企業之合作合約】
檢附【申請人與企業之合作約定書】以茲為證。

依據聯盟作業規範,本聯盟推薦本合作計畫申請科技部補助產學研發聯盟合作計畫。

此致

科技部

聯盟負責人:_____ (簽章)

聯盟印 鑑:_____ (聯盟章)

中 華 民 國 _____ 年 _____ 月 _____ 日

【申請人與企業之合作約定書】

申請人：_____與企業（名稱：_____）

□預計執行合作主題：_____之研發：

□已執行合作主題：_____之研發：

一、 合作期間：自_____年____月____日至_____年____月____日止。

二、 合作研發方向：_____。

三、 廠商分年撥付研發經費（單位：仟元）

第一年： 第二年： 第三年：

四、 廠商所撥付經費，並非來自政府補助款項。



此致

科技部

企業負責人：_____（簽章）

企業印 鑑： _____（公司章）

中 華 民 國 年 月 日